

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和4年2月7日(2022.2.7)

【公開番号】特開2020-167251(P2020-167251A)

【公開日】令和2年10月8日(2020.10.8)

【年通号数】公開・登録公報2020-041

【出願番号】特願2019-65394(P2019-65394)

【国際特許分類】

H 01 L 21/60(2006.01)

10

H 01 L 33/00(2010.01)

H 05 K 13/04(2006.01)

H 05 K 13/02(2006.01)

【F I】

H 01 L 21/60 3 1 1 Q

H 01 L 33/00 H

H 05 K 13/04 Z

H 05 K 13/02 J

【手続補正書】

20

【提出日】令和4年1月28日(2022.1.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

転写元基板から転写された、互いに分離した、多数のチップ部品を保持し、加熱および加圧を行なう工程を経て、転写先基板に転写するのに用いる転写基板であって、
ベース基板と、前記ベース基板表面に形成された未硬化の熱硬化性粘着剤からなる島状粘着部とを備えた転写基板。

30

【請求項2】

請求項1に記載の発明であって、前記島状粘着部を形成する熱硬化性粘着剤がシリコーン樹脂であって、
金属マスクを用いたスキージ塗布により前記島状粘着部が形成された転写基板。

【請求項3】

ウエハ上に形成され、互いに分離した、電極を有する多数のチップ部品を、
前記電極側を保持する第1転写基板に転写した後に、
前記電極の反対側を保持する第2転写基板に転写してから、
配線基板の所定位置にチップ部品を対向配置した状態で、前記チップ部品に前記第2転写基板越にレーザー光を照射して、前記チップ部品を前記配線基板に転写配置して実装する実装方法であって、
前記第1転写基板として、請求項1または請求項2に記載の転写基板を用いる実装方法。

40

【請求項4】

前記チップ部品としてLEDチップを、前記配線基板としてTFT基板を用い、
請求項3に記載の実装方法を用いて画像表示装置を製造する、画像表示装置の製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0018

50

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0018】

上記課題を解決するために、請求項1に記載の発明は、転写元基板から転写された、互いに分離した、多数のチップ部品を保持し、加熱および加圧を行なう工程を経て、転写先基板に転写するのに用いる転写基板であって、

ベース基板と、前記ベース基板表面に形成された未硬化の熱硬化性粘着剤からなる島状粘着部とを備えた転写基板である。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

10

【補正対象項目名】0019

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0019】

請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発明であって、前記島状粘着部を形成する熱硬化性粘着剤がシリコーン樹脂であって、金属マスクを用いたスキー^ジ塗布により前記島状粘着部が形成された転写基板である。

20

30

40

50